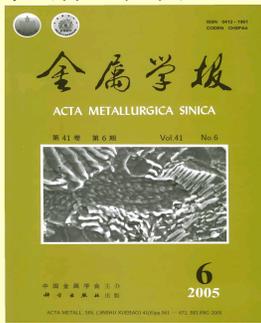


## 本期封面



2005年6期

栏目:

DOI:

论文题目: FePt/Cu多层膜化降低L10-FePt有序化温度

作者姓名: 李宝河, 黄 阔, 杨 涛, 冯 春, 滕 蛟, 朱逢吾

工作单位: 北京科技大学材料物理与化学系, 北京 100083; 北京工商大学数理部, 北京 100037

通信作者: 李宝河

通信作者Email: [lbhe@th.btbu.edu.cn](mailto:lbhe@th.btbu.edu.cn)

文章摘要: 采用直流磁控溅射方法制备FePt/Cu多层膜, 再经不同温度下真空热处理得到有序L10-(FePt)<sub>100-x</sub>Cu<sub>x</sub>薄膜. 结果表明, Cu的添加可以降低FePt 薄膜有序化温度. [FePt(4 nm)/Cu(0.2 nm)]<sub>10</sub>多层膜在350 °C热处理1 h后, 有序度增至0.6, 矫顽力达到421 kA/m. 对插入极薄Cu层促进有序化在较低的温度下进行的热力学和动力学因素进行了讨论.

关键词: FePt/Cu多层膜, L10-FePt有序相, 磁控溅射

分类号: TG111, 0614

关闭